

公司代码：688300

公司简称：联瑞新材

江苏联瑞新材料股份有限公司  
2024 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司可能面临的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），拟派发现金红利总额为人民币9,287.28万元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.95%；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增55,723,659股，本次转增后，公司的总股本为241,469,190股。公司本年度不送红股。上述2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案按公司2024年年度报告披露日公司总股本185,745,531股计算。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	联瑞新材	688300	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柏林	李欣安
联系地址	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区	江苏省连云港市海州区新浦经济开发区
电话	0518-85703939	0518-85703939
传真	0518-85946111	0518-85946111
电子信箱	novoinfo@novoray.com	novoinfo@novoray.com

### 2、报告期公司主要业务简介

#### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司致力于无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售，开展功能性无机非金属粉体材料的研发和制造技术、超微粒子的分散技术、超微粒子的填充排列技术以及超微粒子为载体的表面处理技术为基础的新材料、新技术、新工艺和新应用的研究。

##### 2、主要产品

公司主要产品有利用先进研磨技术制造的微米级、亚微米级角形粉体；火焰熔融法制造的微米级球形无机粉体；高温氧化法和液相法制造的亚微米级、纳米级球形粒子；经过表面处理的各超微粒子、多种方法制造的功能性颗粒以及为解决粒子分散开发的浆料产品。产品广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料（EMC）、液态塑封材料（LMC）、颗粒状塑封材料（GMC）、底部填充材料（UF）、电子电路基板（CCL）、积层胶膜（BF）、热界面材料（TIM）、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以及特高压电力电子制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。

##### 3、服务情况

公司致力于成为全球领先的功能性无机非金属粉体材料及应用方案供应商，在“陪你做填料艺术家”愿景的指引下，紧紧围绕行业发展趋势，战略性配合国内外行业领先客户。公司产品销售至行业领先的 EMC、LMC、GMC、UF、高频高速覆铜板等封装材料、热界面材料、胶黏剂、先进绝缘制品、蜂窝陶瓷、3D 打印、齿科材料等领域客户，品牌影响力显著提升。公司不仅在传统产品质量方面赢得国内外领先客户认可，而且微米级和亚微米级球形二氧化硅、低放射性球形二氧化硅、低放射性高纯度球形氧化铝、球形二氧化钛、氮化物等产品销售至行业领先客户。公司产品除了在中国大陆销售以外，还在日本、韩国、欧美、东南亚、台湾等国家和地区实现销售，

公司和诸多国内外知名企业建立了紧密的合作关系。

## 2.2 主要经营模式

**研发模式：**公司始终高度重视研发工作，坚持以客户需求为导向开展研发。在公司层面设立技术委员会把握公司产品规划和技术方向。技术中心面向新技术、新材料、新应用；工艺部面向新性能、新工艺、新装备；品质管理部负责及时全方位识别客户需求，为客户提供综合解决方案。重视自主创新和产学研用合作创新相结合。

**采购模式：**公司通过科学的管理制度的构建和决策流程的运用来确保采购目标和效率的实现。在制度上，公司通过以质量管理体系为核心，完善供应商的导入以及持续改善等制度，质量管控前移，和供应商建立价值共创互利共赢的伙伴关系，由供应链部对采购工作实行统一管理。主要采取以销定购的采购模式，即按照客户订单采购原材料，同时公司会根据市场情况储备合理库存；公司对供应商执行严格的审核标准，确保采购工作的高效运行。供应链部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建立相关档案。公司认真甄选合格供应商，定期复核采购情况，价格和数量随市场价格和订单而定。

**生产模式：**公司围绕“及时提供满足顾客要求的产品和服务并持续改进”的质量方针，坚持使用行业一流的设备制造产品、注重现场管理的持续改善、长抓不懈推动员工素养提升、始终保持质量上的高标准，建设了行业一流的智能化生产线，已通过 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001 认证。采取“以销定产”的生产模式，公司提前对接下游客户的应用需求，根据客户需求规划设计产品，使之适应不同行业甚至不同客户的需求，为客户提供性能优异的产品，以此与客户建立长期稳定的信赖合作关系。

**销售模式：**公司始终坚持以客户需求为导向，快速响应客户需求，持续优化配置资源服务客户。采用直销为主、代理为辅的销售模式，针对不同领域客户的需求，设计、建立专业化的技术服务和营销队伍。经过多年发展，形成专业、规范、有序、完善的营销体系。客户遍布中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧洲和东南亚等国家和地区。同时，公司立足长远，建立梯队，通过持续专业化的培训，持续提升各部门人员的专业化水平，力争让客户第一时间准确了解公司和产品，快速准确识别客户需求并推荐有竞争力的产品和解决方案，为后续深度做好市场营销、做强做大公司产品、与客户建立长期信赖的合作关系奠定良好的基础。

## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 1.1 行业的发展阶段

公司产品属于新材料行业。作为国民经济的先导性产业和高端制造等的关键保障，新材料产业是国家之间战略竞争的焦点，呈现高性能化、高附加值、绿色化的发展趋势，具有产业规模大、研发投入大、研发周期长、市场高度细分等特点。我国新材料发展已步入新的发展阶段，在新旧动能转化、产业结构升级的大背景下，新质生产力的重要性日益凸显，人工智能、高速通信、航空航天、新能源等领域正快速发展，为新材料的技术研发和推广应用提供了巨大的推动力，作为新材料的硅基氧化物和铝基氧化物等无机非金属功能性粉体材料得到了越来越多的市场机遇，产业链上下游联系愈发紧密，多学科、多部门合作进一步加强，核心技术不断突破，产品类别不断丰富，未来市场前景广阔。

##### 1.1.1 半导体封装材料行业

半导体封装属于半导体制造的后道工艺，是把通过测试的晶圆进一步加工得到独立芯片的过

程，目的是保护芯片并实现芯片内部功能的外部延伸，先进封装是后摩尔时代突破芯片性能瓶颈的关键技术。封装材料位于半导体封装的上游环节，其使用贯穿于整个封装流程，直接影响芯片的封装质量、性能、可靠性。高性能封装材料属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的产业，是先进封装技术持续发展的基础。

近年来，以 HPC、AI、高速通信等为代表的需求牵引，正加速高性能封装材料的发展。先进封装通过提升芯片集成度和互连密度，实现更快的反应速度和更低功耗，进而提高芯片的综合性能，打破了通过缩小晶体管尺寸增加芯片的晶体管数量进而提升芯片性能的方式所面临的经济效能瓶颈。先进封装主要包括 WLCSP（晶圆级芯片规模封装）、FCCSP（倒装芯片级封装）、FCBGA（倒装芯片球栅阵列封装）、2.5D 封装、3D 封装、SiP（系统级封装）等，相较于传统封装，先进封装技术路径更加多元化，对于各级封装环节所需的封装材料要求也更高。随着先进封装的快速发展，先进封装材料行业正迎来新的发展机遇，先进封装材料市场容量逐年增加，并有望持续增长。根据 Yole 数据，2023 年全球先进封装市场规模约为 439 亿美元左右，同比增长 19.62%，并预计 2028 年达到 786 亿美元，2022-2028 年 CAGR 为 10.6%，远高于传统封装的 3.2%。TECHCET 预计受各种终端应用对半导体的需求推动，全球半导体封装材料市场将继续增长，到 2025 年，全球封装材料市场规模将超过 280 亿美元，并将持续稳步增长至 2028 年。

AI 服务器、高速通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等行业的不断发展，带动了 EMC、LMC、GMC、Underfill 等封装材料领域的市场需求，进而对于具有更低 CUT 点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等无机非金属功能性粉体材料的市场需求。公司依靠核心技术生产的球形无机非金属粉体材料具有行业领先的电性能、低 CUT 点、高填充率、高纯度等优良特性，精准满足新一代芯片封装材料的高性能要求。

### 1.1.2 电子电路基板行业

覆铜板（CCL）是用于制作印刷电路板（PCB）的重要基材，在 PCB 中主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，对电路中信号的传输速度、能量损失等具有直接影响。覆铜板种类丰富，按大类分为刚性与挠性，全球市场以刚性覆铜板为主。刚性覆铜板一般分为玻纤布基（常规 FR4、无铅无卤 FR-4、高 Tg FR-4）、纸基（FR-1 等）、复合基（CEM 系列）、特殊材料基（包括高频、高速和封装基板），通过制作成 PCB，应用于下游各类电子产品需求领域。从发展趋势来看，覆铜板呈现高速高频化发展趋势。

目前，伴随着 AI、高速通讯、高性能算力等应用领域的快速发展，下游硬件对于通讯频率、传输速度等方面性能要求不断提升，推动覆铜板不断升级，Super Ultra Low Loss 等级别的高速覆铜板正加速渗透。据 Goldman Sachs Global Investment Research 预计，全球 CCL 市场 2024-2026 年复合增长率为 9%，而高阶 CCL（HDI&高速高频）市场 2024-2026 年复合增长率高达 26%，高端覆铜板保持较高景气度。覆铜板材料升级主要是通过调控介电常数（Dk）和降低介质损耗因子（Df）进而提升电性能，技术难度与上游材料要求也随之提高，对于上游材料而言，需要选择具有较低 Df 的材料以保证在使用过程中减少信号传输时的衰减、时延，以提高信号完整性，在功能性填料选择上，对于粒径、介电损耗等性能指标要求更为严格，因此，以球形二氧化硅等为代表的高性能填料成为行业主流选择。

公司依托 40 年功能性无机非金属粉体材料的技术积累，突破了高频、高速、HDI、IC 载板等高端覆铜板用功能填料的核心技术，产品具有低 Cut 点、低介电损耗、高导热等优良性能，精准满足了高端覆铜板客户的需求。2024 年，销售至高端覆铜板领域的超细球形二氧化硅、球形二氧化钛等产品营收占比持续提高。

### 1.1.3 热界面材料行业

热界面材料作为电子设备热管理系统的关键材料，通过填充在电子元件与散热器之间的间隙

中，构建高效热传导路径，有效降低热阻提升热量传导效率，将电子元件运行产生的热量快速导出至散热装置，从而降低核心部件的工作温度，维持设备稳定运行并延长使用寿命。热界面材料包括导热硅脂、导热凝胶、导热垫片及导热相变材料等，下游广泛应用于消费电子、通讯设备、新能源汽车等领域，据 IDTechEx 预测，全球 TIM 市场预计 2024 年至 2034 年期间的复合年增长率为 14%，2034 年超过 70 亿美元，前景广阔。

近年来，AI 等终端应用技术的快速发展，对数据中心、AI 手机等领域硬件性能要求持续提升，硬件密度和功能愈发强大，热管理需求凸显。根据 TrendForce 数据，2023 年全球 AI 服务器出货量为 120.5 万台，2026 年有望达 236.9 万台，年均复合增速约 25%。据 IDC 预测，2024 年全球 AI 手机出货量将达 2.34 亿部，同比+364%，到 2025 年，生成式人工智能手机的出货量预计同比增长 73.1%。电子器件的散热需求的持续提升，持续推动高性能热界面材料市场空间。

新能源汽车是实现“双碳”目标的重要途径，从碳排放的来源来看，发电端及交通领域是碳排放的核心来源，因此，打造以新能源车为代表的清洁能源应用场景是迈向碳中和的必经之路。随着以旧换新、减免车辆购置税等政策的持续发力，将对汽车产业转型、新能源汽车市场增长起到积极的推动作用，新能源汽车渗透率有望持续提升。根据中国汽车工业协会数据显示，2024 年我国新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4% 和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。新能源汽车产业保持了较快发展势头。在新能源汽车领域，热界面材料广泛应用于电控模组、驱动电机、电感模块、电源灌封、ADAS 传感器等，对于各器件稳定、高效、安全的运行起到了关键性作用。随着新能源汽车的日益普及和智能化程度提高，将拉动热界面需求持续提高。

热界面材料基材往往采用高分子材料，而高分子材料导热性能有限，所以通常需要添加热传导率较高的球形氧化铝等材料来改善其热传导性。伴随高导热热界面材料的需求日益提升，催生作为导热填料的球形氧化铝、氮化物等市场需求的提高，导热填料的市场需求及发展前景日趋明显。

#### 1.1.4 新应用领域

随着国民经济的高质增长，特高压、AIDC 等行业的快速发展，对于电力用绝缘制品提出了更高的要求，新一代绝缘材料在不仅需要承受高压输电时超高电压的极限考验，还对绝缘件的耐气候、极端条件下局放标准、稳定性、环保性、耐老化等性能提出了更高要求，除了聚合物要求提升外，功能性填料的作用也愈加明显，经过特殊颗粒设计的填料在解决绝缘件在更加恶劣的气候环境中强度提升、局放降低等方面效果显著。微米级、亚微米级、纳米级球形二氧化硅在 3D 打印材料、齿科材料、胶片显影液等方面，利用合理的粒度分布、低比表面积、高流动性、适宜的光学特性等特点，对于制品的性能有了大幅度地提升。

#### 1.2 基本特点

公司研发、制造、销售以硅基氧化物、铝基氧化物等球形粉体为核心产品的功能性无机非金属粉体材料，具有技术新、工艺新、应用新、测试条件复杂且更新快等特点，属于新型的跨领域、跨学科、跨专业的尖端机能材料。产品广泛应用于芯片封装材料、电子电路基板、新型绝缘制品、导热界面材料、胶粘剂、蜂窝陶瓷、3D 打印、齿科材料等行业，服务于高速通讯、服务器、消费电子、汽车工业、航空航天、特高压传输、增材制造、齿科健康等领域。

公司产品作为一种性能优异的无机非金属粉体材料，具有高纯度、高填充、高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数、导热性好、介电损耗（Df）低等优良特性，属于新材料领域中的细分赛道产品，下游应用中不同行业对于产品的需求点、关注点存在差异，甚至完全不同。在覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂等各主要应用领域都因上述一项或多项优良特性发挥着无机非金属粉体材料的作用，具有相近的功能应用点，但不同应用领域对于无机非金属粉体材料的性能需求和

侧重点仍存在一定的差异，对无机非金属粉体材料的技术指标也有着不同的要求。同样的结构和化学成份，随着产品粒度、粒形、表面能、比表面积和表面改性体系的变化，其在相类似的聚合物中应用时性能和外观等表现会明显不同。针对于不同的应用，产品需要从原材料开始，设计选择原物料的化学成分，针对性的设计配方、生产装备和生产工艺，才能满足不同领域的应用要求。无机非金属粉体材料作为新型复合材料的功能改善、性能提升的关键核心材料，属于新材料行业中不可或缺的一员。

### 1.3 主要技术门槛

无机非金属粉体材料是典型的技术密集型产品，其研发生产涉及无机化学、有机化学、燃烧学、流体力学、无机非金属材料学、机械力学等学科，属于典型的跨学科、跨专业、跨领域的新材料行业，需要大量的复合型研发和工程技术人员；产品技术含量高，依赖于在材料行业的长期技术工艺经验积累和研发投入技术创新，产品性能的优化也要经历持之以恒地探索和反复实验，人才培养需要较长时间。

无机非金属粉体材料下游应用领域广泛，技术迭代快速，研发解决了功能问题，但是只是应用的初级阶段；随着产品的不断迭代，性能的提升需要对于技术工艺和装备的研究持续不断地开展。需要供应链上下游之间深度的信任和融合，共同推动产品的生产和应用技术不断进步。

### (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为国内功能性无机非金属粉体材料领域的龙头企业，依托四十年持续深耕形成的技术底蕴，突破多项核心关键技术，自主研发并掌控了多种类型功能性无机非金属粉体材料的生产能力，形成了以硅基氧化物、铝基氧化物为基础，多品类规格齐备的产品布局。公司是国家高新技术企业，被工信部认定首批专精特新“小巨人”企业，成功入选国家制造业单项冠军示范企业。

公司承担了科技部国家重点研发计划、江苏省战略性新兴产业发展专项；完成多项江苏省科技成果转化项目和国家、省级技术革新项目，承担的“火焰法制备球形硅微粉成套技术与产业化开发及在集成电路的应用”突破国外“卡脖子”技术封锁，荣获中国建材联合会/中国硅酸盐学会科技进步类一等奖。多项产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。公司建成并拥有国家特种超细粉体工程技术研究中心硅微粉产业化基地、国家博士后科研工作站、江苏省石英粉体材料工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省无机非金属功能性粉体材料工程研究中心和电子封装用石英粉体材料新兴产业标准化试点等称号。

通过自主创新公司实现了向全球高端市场突破的跨越式发展，攻克了先进封装（2.5D、3D、SIP 封装等）、新一代高频高速覆铜板（M7、M8 等）、高导热界面材料等领域用功能性填料的技术难关，成为 AI 服务器、高性能处理芯片、高导热材料等领域核心上游关键材料供应商，产品结构中高阶产品占比持续提升，市场竞争力不断增强。

### (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新材料是国民经济建设、社会进步和国防安全的物质基础。在百年未有之大变局背景下的竞争中，材料的作用显得更为重要，开展新材料强国研究，对我国由制造大国向制造强国转变具有重要的战略意义。在科学技术强国和国内经济增长的背景下，“十四五”规划也再次强调科技的关键战略地位，为功能性无机非金属粉体材料行业的增长提供了保障。

中国工程院发布的《面向 2035 的新材料强国战略研究》中指出，要促进新材料行业的新技术、新模式、新业态发展，实现新材料产业转型升级和结构调整，提升我国新材料自主保障能力和市场竞争力，鼓励以企业为主的新材料自主创新体系，加强新材料研发平台建设，培育与新材料产业发展相适应的人才队伍。

公司自成立以来便深耕功能性无机非金属粉体材料行业，在颗粒设计、高温球化、液相合成、燃烧合成、晶相调控、表面修饰以及模拟仿真等核心技术方面具有行业领先优势。近年来，公司不断地纵向深化打破国外同行等在核心领域的技术封锁和产品市场垄断，纵向持续拓宽功能性无机非金属粉体材料品类，成为了国内相关行业的引领者。随着新一代信息技术领域的快速发展，新兴应用场景对功能性无机非金属粉体材料在下游领域的应用也提出了新的要求，公司依托自身核心技术，凭借长期在新材料领域的研发创新经验的深厚积累，可以快速、准确、高效配合客户新产品的研发需求和原有产品的升级迭代，与下游产业发展深度融合。

随着 AI、HPC 等应用终端技术的快速发展，以及新能源、汽车电子等领域需求的不断扩大，行业呈增长的趋势。随着消费者需求的不断变化和升级，消费终端产品升级换代也将进一步提速，进而拉动功能性无机非金属粉体材料的需求增长。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	1,971,962,660.24	1,754,701,349.09	12.38	1,537,623,162.65
归属于上市公司股东的净资产	1,507,675,837.88	1,347,439,223.00	11.89	1,230,031,593.07
营业收入	960,360,374.93	711,682,420.08	34.94	661,954,238.89
归属于上市公司股东的净利润	251,374,413.14	173,994,421.82	44.47	188,240,500.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,912,895.41	150,270,057.37	51.00	149,951,167.89
经营活动产生的现金流量净额	254,708,483.84	246,948,264.23	3.14	240,677,481.37
加权平均净资产收益率(%)	17.81	13.60	增加4.21个百分点	16.32
基本每股收益(元/股)	1.35	0.94	43.62	1.01
稀释每股收益(元/股)	1.35	0.94	43.62	1.01
研发投入占营业收入的比例(%)	6.29	6.66	减少0.37个百分点	5.82

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	202,281,462.28	241,076,646.87	250,350,765.09	266,651,500.69
归属于上市公司股东的净利润	51,675,319.33	65,811,811.63	67,388,229.20	66,499,052.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,554,579.27	60,140,771.53	63,735,977.94	57,481,566.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,022,428.62	115,130,639.61	26,204,445.36	128,395,827.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4、 股东情况

## 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		7,096					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		8,580					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0					
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
广东生益科技股份 有限公司	0	43,210,000	23.26	0	无		境内非国有 法人
李晓冬	0	37,485,323	20.18	0	无		境内自然人
江苏省东海硅微粉 厂	0	32,407,500	17.45	0	无		其他

瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	3,038,784	3,038,784	1.64	0	未知	未知
刘春昱	51,300	2,651,300	1.43	0	未知	境内自然人
阮建军	0	2,236,086	1.20	0	无	境内自然人
曹家凯	0	1,728,400	0.93	0	无	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	-885,232	1,443,070	0.78	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	-47,319	1,206,354	0.65	0	未知	未知
王松周	-26,115	1,160,000	0.62	0	无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日，李晓冬持有江苏省东海硅微粉厂 100%股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

#### 存托凭证持有人情况

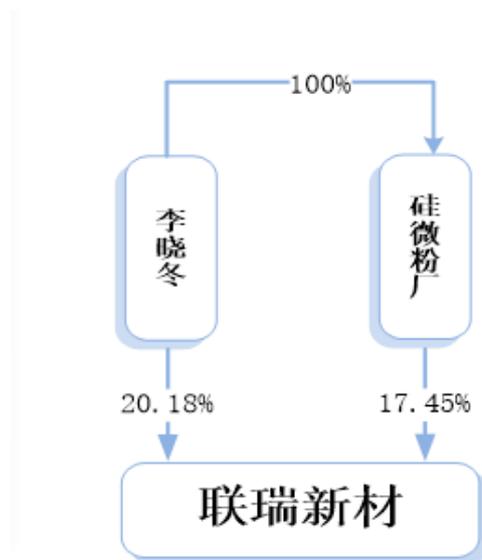
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

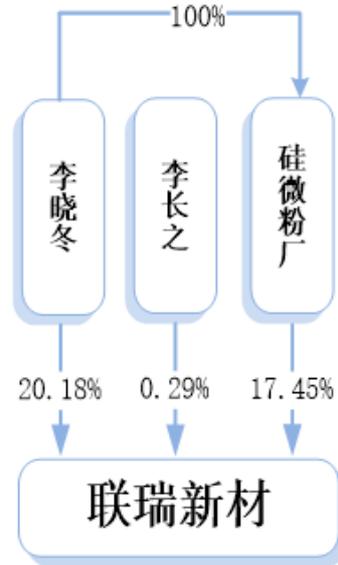
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5、公司债券情况

适用 不适用

## 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为 96,036.04 万元，较 2023 年同期增长 34.94%。归属于上市公司股东的净利润 25,137.44 万元，较 2023 年同期增长 44.47%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用